

# マテリアルバランス

事業活動にともなうINPUT/OUTPUTを的確に把握し、環境保全活動のさらなる向上につなげます。

## カシオグループのマテリアルバランス

カシオでは、デバイス事業とエレクトロニクス機器事業、それぞれの事業活動において、物質、エネルギーの投入量と、そこから排出される環境負荷を把握し、環境保全活動のさらなる向上に結び付けています。

近年、カシオグループ全社のCO<sub>2</sub>排出量は事業の拡大にともなう上昇傾向にあります。また、国内におけるデバイス事業の拡大にともなう水使用量増加の対策としては、水の循環使用に努めています。

また、廃棄物においても、再資源化は重要な課題と捉え、優れた再資源化技術を持つ処理業者を優先的に採用しています。さらに、デバイス工程の処理に使用される薬品などの化学物質の削減にも努めるなど、広範囲な事業活動のなかで、さまざまな環境対策に取り組んでいます。

※パフォーマンスデータの詳細はウェブサイトにてご覧ください。

URL <http://www.casio.co.jp/csr/>

## デバイス事業のマテリアルバランス

デバイス事業においては、昨今のパソコン、携帯電話などの普及により、1990年以降大幅な生産増が続いています。これにともない、工場規模の増大、設備の増加のため、CO<sub>2</sub>排出総量においては、2004年度で74,607トンとなり、1990年度の20,144トンとの比較で3.7倍となっています。

この事業ではクリーンルーム用の熱源や、排水を無害化処理する装置の終日稼働などが、生産の増減に関係なくほぼ一定の状態で行われており、これが大きなエネルギー、水消費の要因となっています。その解決策として、例えばよりCO<sub>2</sub>排出の少ない燃料（A重油から

軽油）に切り替えるなど、各事業所がCO<sub>2</sub>の排出削減に向けた努力を続けています。

また、廃棄物処理については、使用する薬液が大きく増加したことから、各事業所、拠点毎に最適な処理施設を持つ業者の選択によりリサイクルに努め、埋立量削減活動を各々展開しています。この結果、調査対象6事業所・拠点のうち、2004年度までに5事業所・拠点（高知カシオ、甲府カシオ（本社、一宮）、カシオマイクロニクス（山梨）、カシオ計算機（八王子技術センター））でゼロエミッション（総廃棄物量に対する埋立量1%以下）を達成しました。残る1事業所においても、埋立率は1.23%であり、2005年度中に達成する見通しです。

## エレクトロニクス機器事業のマテリアルバランス

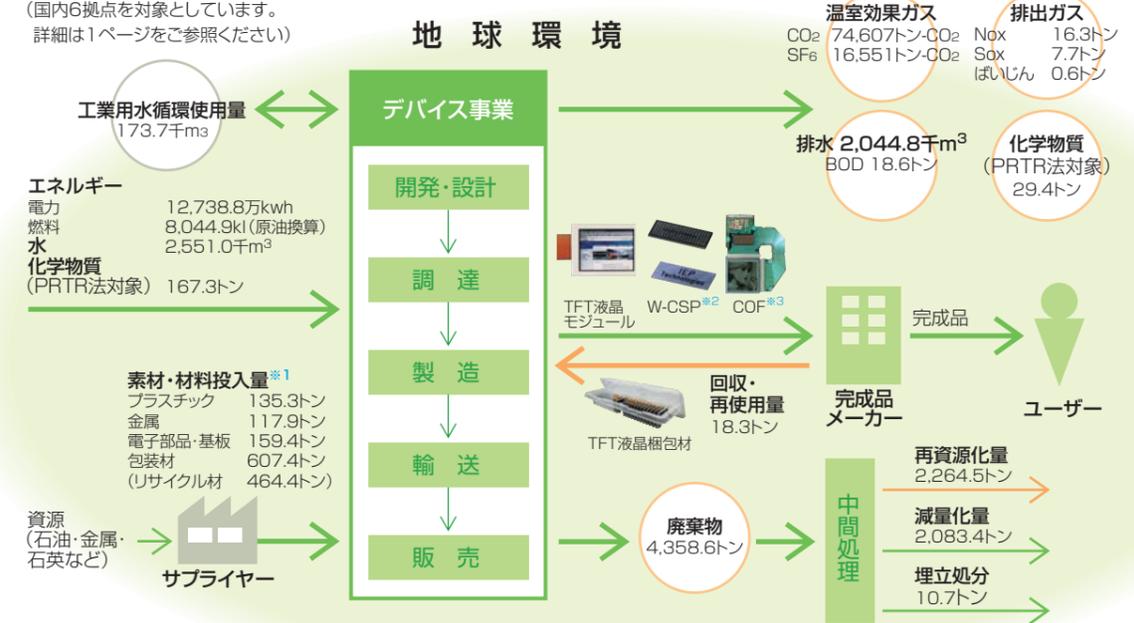
エレクトロニクス機器事業においては、2002年に山形カシオにおけるコジェネレーションの導入にともない、電力使用量は削減されましたが、その反面、燃料使用量の増大が、CO<sub>2</sub>排出量の増大要因となっています。このためCO<sub>2</sub>排出総量では、2003年度13,891トン-CO<sub>2</sub>に対し、2004年度17,417トン-CO<sub>2</sub>と、前年比25%以上の増加となっています。

また、生産高原単位では、2003年度0.153（トン-CO<sub>2</sub>/百万円）に対し、2004年度0.202（トン-CO<sub>2</sub>/百万円）と、32%以上の増加となっています。京都議定書における日本の目標が絶対値で6%の削減であることを踏まえ、さらに省エネ対策を継続していきます。

廃棄物処理においては、デバイス事業と同様に、各事業所、拠点毎に最適な処理施設を持つ業者の選択によってリサイクルに努め、埋立量削減活動を各々展開しています。この結果、国内調査対象8事業所・拠点のうち、2004年度までに5事業所・拠点（山形カシオ、カシオ電子工業、カシオ計算機（本社、羽村技術センター）、カシオ日立モバイルコミュニケーションズ）でゼロエミッションを達成しました。残る3事業所については継続的な改善を進めています。

## デバイス事業のINPUT / OUTPUT

（国内6拠点を対象としています。詳細は1ページをご参照ください）



※1 素材・材料投入量:TFT液晶モジュール、W-CSP、COFを対象

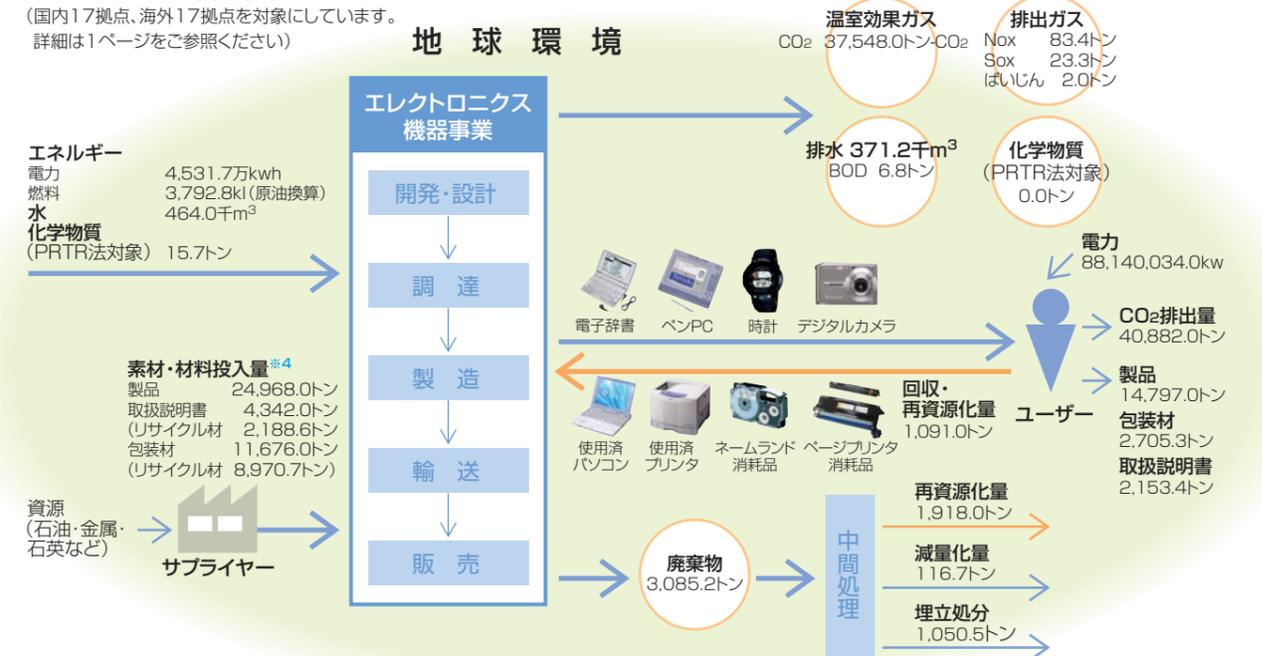
※2 W-CSP:パッケージングプロセスのすべてがウエハー状態で完結するICパッケージ。チップと全く同じ寸法までパッケージを小型化できるのが特徴。

※3 COF:Chip on Filmの略で、薄い樹脂製フィルムにLSIチップを直接結合したもの。限られたスペースにLSIを効率的・高密度に実装することが可能。

お詫びと訂正:2004年度環境経営報告書において素材・材料投入量で「包装材料0.5トン(そのうちリサイクル材0.3トン)」と記載しておりましたが、「包装材料501.0トン(そのうちリサイクル材384.1トン)」に訂正させていただきます。

## エレクトロニクス機器事業のINPUT / OUTPUT

（国内17拠点、海外17拠点を対象にしています。詳細は1ページをご参照ください）



※4 素材・材料投入量:各品目の代表機種より推定

お詫びと訂正:2004年度環境経営報告書において素材・材料投入量で「包装材料12,154.5トン(そのうちリサイクル材10,052.6トン)」と記載しておりましたが、「包装材料11,654.0トン(そのうちリサイクル材8,625.0トン)」に訂正させていただきます。